

证券代码：300054

证券简称：鼎龙股份

湖北鼎龙控股股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20260716

投资者关系 活动类别	☒特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他
参与单位名称 及人员姓名	2026 年 7 月 14 日下午 14:00~17:00：国泰基金：郑浩，嘉实基金：孟丽婷、郑道涵，睿远基金：马川，华福证券：刘贤洁，拾贝投资：梁君岳，平安电子：徐勇，国投电子：周赵羽彤，中银证券：余嫋嫋，国信电子：张大为，平安电子：陈福栋，华创化工：陈俊新，国泰基金：智健，国投瑞银：桑俊，银河电子：刘来珍，交银基金：李震琦等，共 120 名投资者及证券人员 2026 年 7 月 15 日上午 9:30~11:00：平安养老：周传根、王帅、周光远、钱冠宇、童秋涛，共 5 名投资者及证券人员
时间	2026 年 7 月 14 日下午 14:00~17:00，2026 年 7 月 15 日上午 9:30~11:00
地点	公司 6 楼多功能厅
上市公司接待 人员姓名	2026 年 7 月 14 日下午 14:00~17:00：董事长朱双全先生、总经理朱顺全先生、财务总监姚红女士、董秘杨平彩女士、董事长助理兼投关总监熊亚威先生 2026 年 7 月 15 日上午 9:30~11:00：董事长助理兼投关总监熊亚威先生
投资者 关系活动 主要内容 介绍	公司介绍： 鼎龙股份是国内领先的关键大赛道领域中各类核心创新材料的平台型公司，主营业务横跨半导体材料板块、锂电材料板块和打印复印关键材料板块等。现阶段，公司重点聚焦半导体创新材料业务，业务覆盖：半导体制造用 CMP 工艺材料和晶圆光刻胶、半导体显示材料、半导体先进封装材料三个细分板块，是集成电路用 CMP 抛光垫国内供应龙头，占据 OLED 新型显示材料 YPI、PSPI 国内供应领先地位，深度布局半导体 KrF/ArF 晶圆光刻胶、半导体先进封装材料等业务，新近切入新能源锂电关键功能材料领域，推动公司高速可持续发展。 问 1：请介绍公司上半年抛光垫业务板块的最新进展如何？ 答：公司以集成电路核心材料主业为基本盘，同步发力布局大硅片配套抛光耗材、先进封装材料、碳化硅配套材料、玻璃基板材料等前沿赛道，各细分领域现阶段均完成阶段性突破。各新兴赛道客户导入、试样验证及商务

	订单拓展工作均有序开展，客户认证批量落地、批量订单持续实现稳步突破，各板块经营向好，为中长期营收规模扩容筑牢支撑。 抛光垫板块经营表现亮眼，上半年板块营收同比增幅达 57%，增长动能强劲。2026 年 6 月公司抛光垫单月出货规模首次突破 5 万片关口，刷新公司月度出货历史纪录，直观反映下游客户对公司抛光垫产品性能的高度认可，板块长期增长确定性持续增强。伴随下游终端需求持续扩容，公司潜江三期抛光垫产线已开工建设；项目规划年产能 30 万片，产品研发及量产方向重点覆盖玻璃基板专用 CMP 抛光垫、2 米以上超大尺寸高端抛光垫，精准对接行业新兴应用需求。当前抛光垫业务已形成规模化营收，在此基础上依旧维持高增速运行，产销供需持续紧平衡，产品市场竞争优势不断强化。 问 2：请问公司高端晶圆光刻胶近期取得新的订单，相关的具体情况如何？ 答：此次高端半导体光刻胶批量订单顺利落地，充分印证国内多家头部晶圆制造企业对公司一体化自研产线、产品综合性能及稳定交付能力的高度认可。公司光刻胶业务核心竞争壁垒主要体现在三大维度：其一，潜江二期产线系国内首条集有机合成、高分子聚合、高纯提纯、光刻胶调配于一体的全流程量产产线，光刻胶树脂、光产酸剂、高纯单体等关键核心原料均实现自主研发与自产自用，金属杂质、稳定性等指标对标国际头部竞品，从原材料端规避外部供应链制约风险；其二，产品布局体系完善，公司已累计完成四十余款高端晶圆光刻胶开发，近三十款产品完成下游客户送样评测，当前实现稳定批量供货的 ArF、KrF 光刻胶型号共 8 款，相较 2026 年一季度新增 5 款量产规格，同步布局 BARC、SOC 等光刻配套辅材，能够为晶圆制造客户提供全套光刻材料一体化配套方案；其三，具备快速定制化迭代开发能力，可结合不同晶圆厂产线工艺参数灵活优化产品配方，适配多代半导体制程生产要求。 从全年供货放量节奏来看，2026 年上半年公司光刻胶整体交付体量同比实现平稳增长；下半年核心工作将推动处于加仑级试样验证阶段的产品完成订单转化，稳步提升潜江 300 吨光刻胶产线稼动水平。中长期产能规划将紧跟国内晶圆厂新建、扩产进度统筹排布，持续匹配国内高端光刻胶国产化替代的长期市场需求。 问 3：请问公司 CMP 材料在玻璃基板配套材料领域的布局情况如何？ 答：公司长期持续看好玻璃基板配套材料赛道发展前景，提前完成相关技术储备与产能前置布局。近期公司抛光垫产品斩获板级封装核心客户批量订单，将大批量导入以玻璃基板为载体的板级封装产线投入使用。本次订单是公司抛光垫产品在先进封装赛道的又一重要产业化成果，继成功导入 2.5D、3D 封装产线后，进一步实现板级封装场景突破，持续助力国内先进封装产业链国产化发展。与此同时，公司规划建设潜江三期抛光垫项目设计年产能 30 万片，产品开发与量产重心聚焦玻璃基板专用 CMP 软垫、2 米及以上超大尺寸抛光垫两大高增长赛道，精准匹配 HBM、光电共封装等行业前沿制造工艺需求。从客户端认证进度来看，玻璃基板作为下一代先进
--	--

	封装高密度互连核心方案，对抛光耗材的综合性能标准要求更高；现阶段公司自研玻璃基板专属软质抛光垫已送至多家布局玻璃基板产线的头部封测、晶圆制造企业开展试样验证，产品在晶圆平坦化效果等关键指标上表现突出。 该类产品核心技术壁垒主要分为三大维度：第一，差异化专属配方体系，针对玻璃基材特性优化抛光垫内部结构，兼顾材料去除速率与低缺陷两大核心工艺诉求；第二，专属量产工艺门槛，新建产线可兼容各类规格玻璃基板的抛光加工需求；第三，抛光垫与抛光液一体化协同优势，公司后续将同步配套开发适配玻璃基板场景的抛光液产品，可为下游客户提供整套 CMP 耗材综合解决方案，有效缩减客户联合工艺验证周期。 结合产能现状与中长期发展规划来看，公司当前有两条合成革湿法成型软垫生产线，合计年产能达 50 万片（含缓冲垫），伴随第三代半导体衬底抛光需求持续攀升，叠加玻璃基板新兴赛道带来的增量市场，现有产能已无法充分承接中长期潜在订单。待潜江三期扩建项目建成投产后，公司将补齐晶圆制造、化合物半导体衬底、玻璃基板先进封装全应用场景抛光垫产品布局，进一步强化公司 CMP 耗材一体化平台竞争优势，充分承接先进封装行业长期发展红利。 问 4：请问公司 2026 年上半年度预计业绩情况如何？ 答：公司 2026 年上半年经营业绩实现稳步增长，预计实现营业收入约 19.25 亿元，较上年同期增长约 11%；预计实现归属于上市公司股东的净利润 5.1 亿元至 5.4 亿元，较上年同期增长 63.96%至 73.61%。若剔除出表的打印耗材终端业务相关利润影响，公司上半年预计实现的归属于上市公司股东的净利润同比增幅将超过 80%，主营业务盈利能力凸显。各核心业务板块具体经营情况如下： ① CMP 抛光液及清洗液业务：作为公司半导体材料板块核心新增长极，子公司鼎泽旗下抛光液（含清洗液，不含体系内研磨粒子）业务在报告期内取得突破性进展，上半年合计实现营业收入同比增长 63%，实现规模盈利约 4700 万元。其中，6 月份单月抛光液及清洗液销售额突破 4000 万元，创下月度销售额历史新高。随着下半年产品销售规模的持续扩大，该业务的市场竞争力、毛利率水平及盈利水平将进一步提升，为公司业绩增长注入持续动力。② CMP 抛光垫业务：上半年该业务实现营业收入同比增长 57%，经营成效显著。6 月份单月产品出货量首次突破 5 万片，刷新月度出货量历史纪录，充分体现了下游市场对公司抛光垫产品性能、品质的高度认可，也彰显了该业务持续向好的发展态势。③ 高端晶圆光刻胶业务：报告期内，公司高端晶圆光刻胶业务商业化进程显著提速，合计获得约 1000 加仑采购订单，产品批量交付规模持续提升。截至目前，公司已累计布局 40 余款高端晶圆光刻胶产品，其中近 30 款产品已送至下游客户开展送样验证测试，客户端在测产品型号数量较上年同期实现翻倍。同时，公司同步布局多款 BARC、SOC 等光刻配套辅材，持续完善光刻材料产品矩阵，强化核心竞争力。④ 半导体显示材料业务：受下游显示面板厂商产能稼动率不足的行业阶段性因素影响，公司半导体显示材料业务上半年营业收入同比略有下滑，呈现阶段性波动特征。但在此背景下，公司相关产品的市场占有率及新产品
--	--

	覆盖度仍实现持续提升，业务整体竞争力得到显著增强，为后续行业复苏后的业务反弹奠定了坚实基础。 问 5：公司目前正在推进 H 股发行上市工作，请问公司的相关发展规划？ 答：公司筹划 H 股发行并在香港联合交易所主板上市，核心围绕全球化产业布局、海外市场拓展、中长期资本储备三大核心战略目标推进，旨在进一步夯实公司全球市场竞争力，助力长远发展。作为国内关键创新材料领域的平台型企业，公司目前已形成多系列创新材料产品矩阵，相关产品已深度渗透国内市场并实现规模化销售。本次筹划 H 股上市，核心目的在于深化公司创新材料业务的全球化布局，加速海外客户开发进程，推动海外产能建设与研发投入落地，全面提升公司国际品牌影响力及全球市场综合竞争力。同时，通过搭建 A+H 双融资平台，进一步拓宽公司国际化融资渠道，增强境外资本运作能力，为公司半导体材料、显示材料等核心产品的海外研发投入、产线建设、海外市场并购及产业链上下游布局提供长期、稳定的资金支撑，助力公司打造具备全球竞争力的创新材料龙头企业。
附件清单	无
日期	2026 年 7 月 15 日